

# 図研エルミック株式会社 会社説明会

---

(東証マザーズ：4770)

2012年5月29日

代表取締役社長 朝倉 尉

# 会社紹介

---

# 会社概要



社名	図研エルミック株式会社		
設立	1977年4月30日		
資本金	1,202,036,093円 (2012年3月31日現在)		
従業員数	84名 (2012年3月31日現在)		
事業所	本社 (横浜市港北区新横浜3-1-1図研新横浜ビル) 大阪営業所 (大阪市浪速区湊町1-4-38号近鉄新難波ビル9階)		
役員	代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 監査役(常勤) 監査役 監査役	勝部 迅也 朝倉 尉 小堀 秀男 下条 雅人 大門 肇 安藤 貴三男 新井 浩之	
関係会社	株式会社 図研		

# 沿革



- 1977年 マイコン関連の総合システムハウスとして、(株)エルミックシステムを横浜市に設立
- 1983年 ELXシリーズ(ELX-86M)販売開始
- 1984年 大阪営業所開設
- 1991年 ISDNボード(PC-INS)販売開始
- 1995年 半導体製造装置向け通信ソフトウェア(GEM)販売開始
- 1998年 組込み専用インターネットプロトコル(KASAGO TCP/IP)販売開始
- 2000年 ITRON仕様準拠RTOS(ELX-ITRON)販売開始  
東証マザーズに上場(7月25日)
- 2002年 KASAGO IPv6販売開始
- 2003年 KASAGO IPv6が組込み用プロトコルとして国内初の『IPv6 Ready Logo』取得
- 2004年 半導体製造装置向け通信ソフトウェア(SoftCOMGEM300)販売開始
- 2005年 ウェスコム社と合併し、エルミック・ウェスコム株式会社に
- 2006年 TCP/IPオプションソフトウェア(IPSec)販売開始
- 2007年 株式会社シーイーシーと業務提携発表  
組込み向けマルチメディア通信プロトコル(SIP)販売開始
- 2008年 株式会社図研と業務資本提携発表
- 2009年 株式会社図研よりSoC事業部を会社分割により承継(6月)  
図研エルミック株式会社へ社名変更(7月)  
次世代ネットワーク向け高付加価値ミドルウェアZe-PROシリーズ(RTP, ONVIF)販売開始  
開発プラットフォーム製品群Z-SYSシリーズ販売開始  
NECエレクトロニクス殿(現ルネサス エレクトロニクス殿)とXBridge, PFESiPでの協業開始
- 2010年 PC98アーキテクチャ互換システム(iNHERITOR II)販売開始  
シリアル-LANコンバーター(MPC)販売開始  
マルチスタイルライブラリ YAMAMEシリーズ(JPEG XR)販売開始
- 2011年 韓国Miware Inc.と販売代理店契約締結 韓国で「KASAGO」「Ze-PRO」「ELX」販売開始  
ONVIF NVS部ライブラリ「Ze-PRO IPrec」販売開始
- 2012年 Ze-PRO IPrecが日刊工業新聞『十大新製品賞 中堅・中小企業賞』を受賞

# 事業概要

## 組込システム技術を2つのアプローチでご提供



組込SW開発 / LSI・基板開発 / C Based LSI Design

# 2012年 3月期 決算報告

---

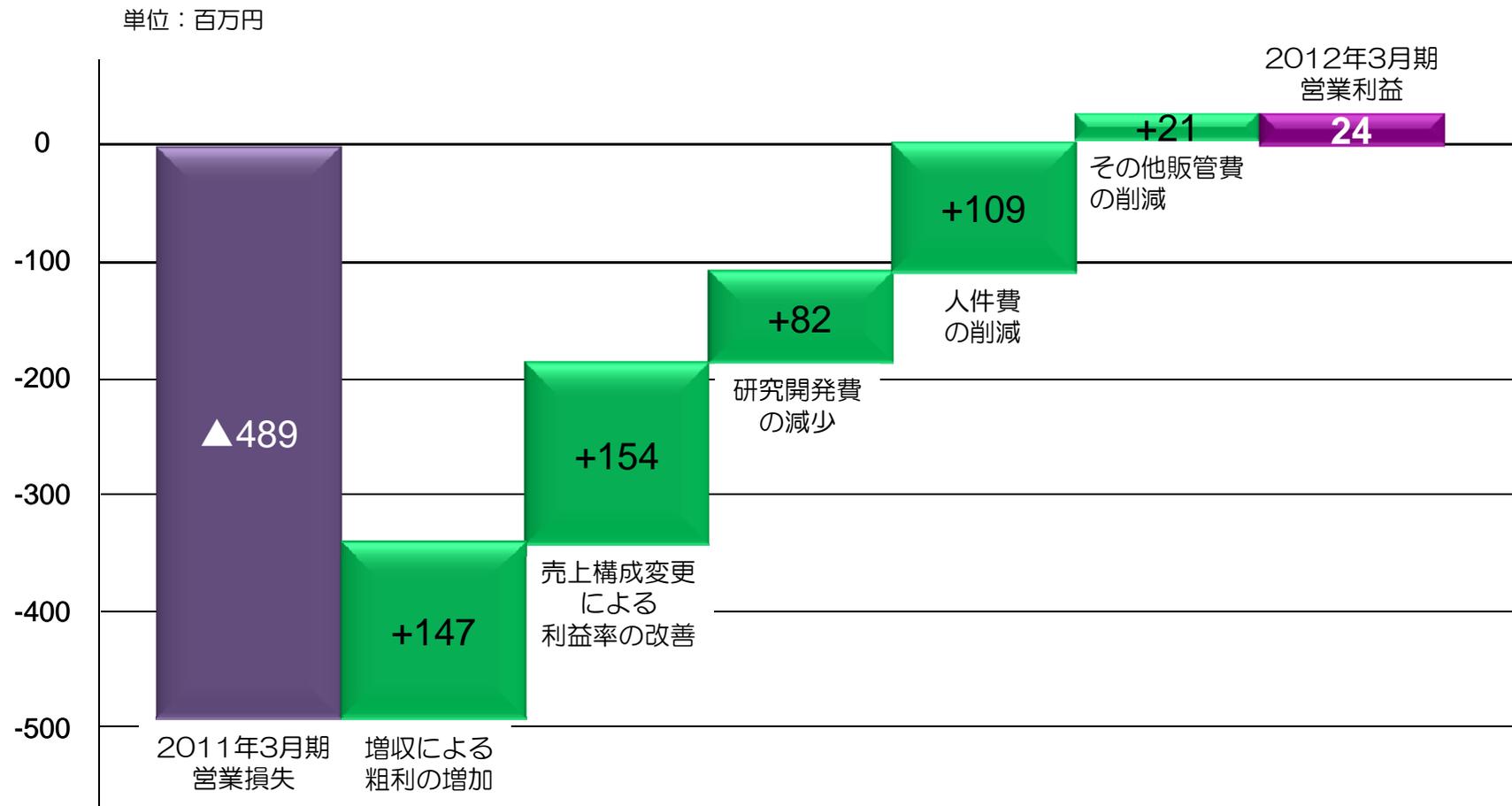
# 業績結果

第35期 単位：百万円, %	上半期		第3四半期		第4四半期		下半期		通期	
	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比
売上高	666	143%	264	126%	567	161%	831	148%	1,498	146%
売上原価	399	146%	170	98%	311	118%	482	110%	881	124%
売上総利益	267	139%	93	258%	255	289%	349	281%	617	195%
販管費	291	65%	156	80%	144	86%	301	83%	593	74%
営業利益	▲23	+229	▲62	+95	110	+188	48	+284	24	+513
経常利益	▲21	+217	▲57	+85	113	+180	55	+265	34	+482
当期純利益	▲23	+189	▲58	+84	29	+212	▲29	+297	▲52	+487
受注残高	447	133%	-	-	-	-	-	-	388	112%

- 5期ぶりの営業利益・経常利益の黒字化
- 製品販売を主体としたビジネスモデルへの移行に伴う、売上総利益率の改善
- 新製品リリースによる売上高の増加

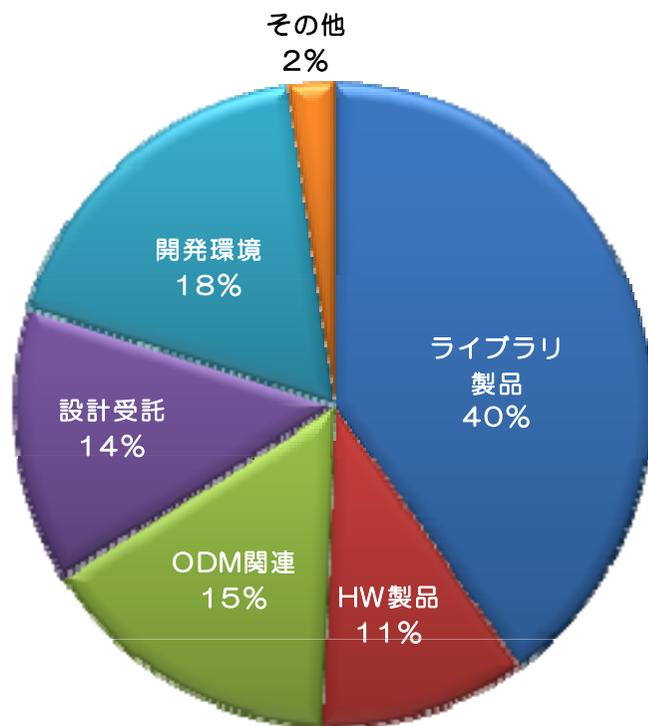
■ エルピーダメモリ株式会社社債売却に伴うによる特別損失(80百万円)

# 営業利益 改善の内訳

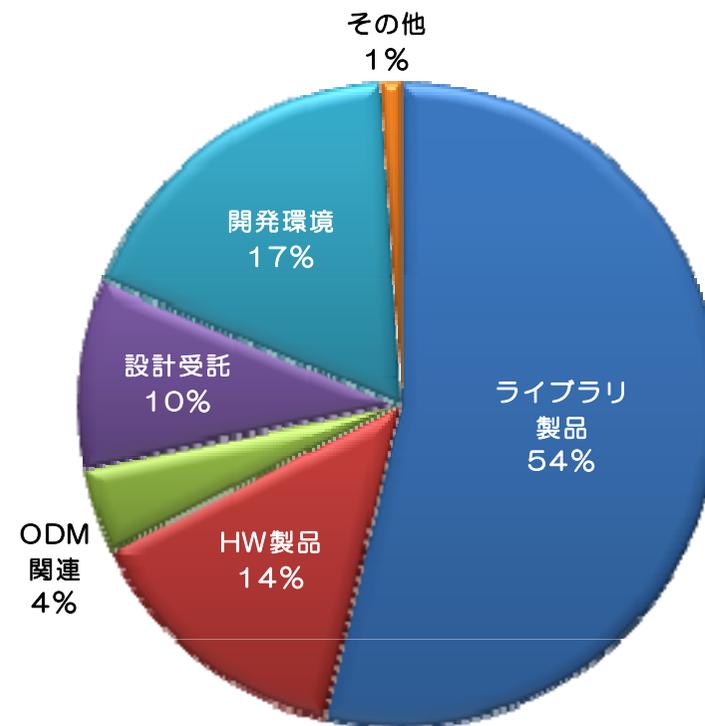


# 製品区分別 構成比率

売上

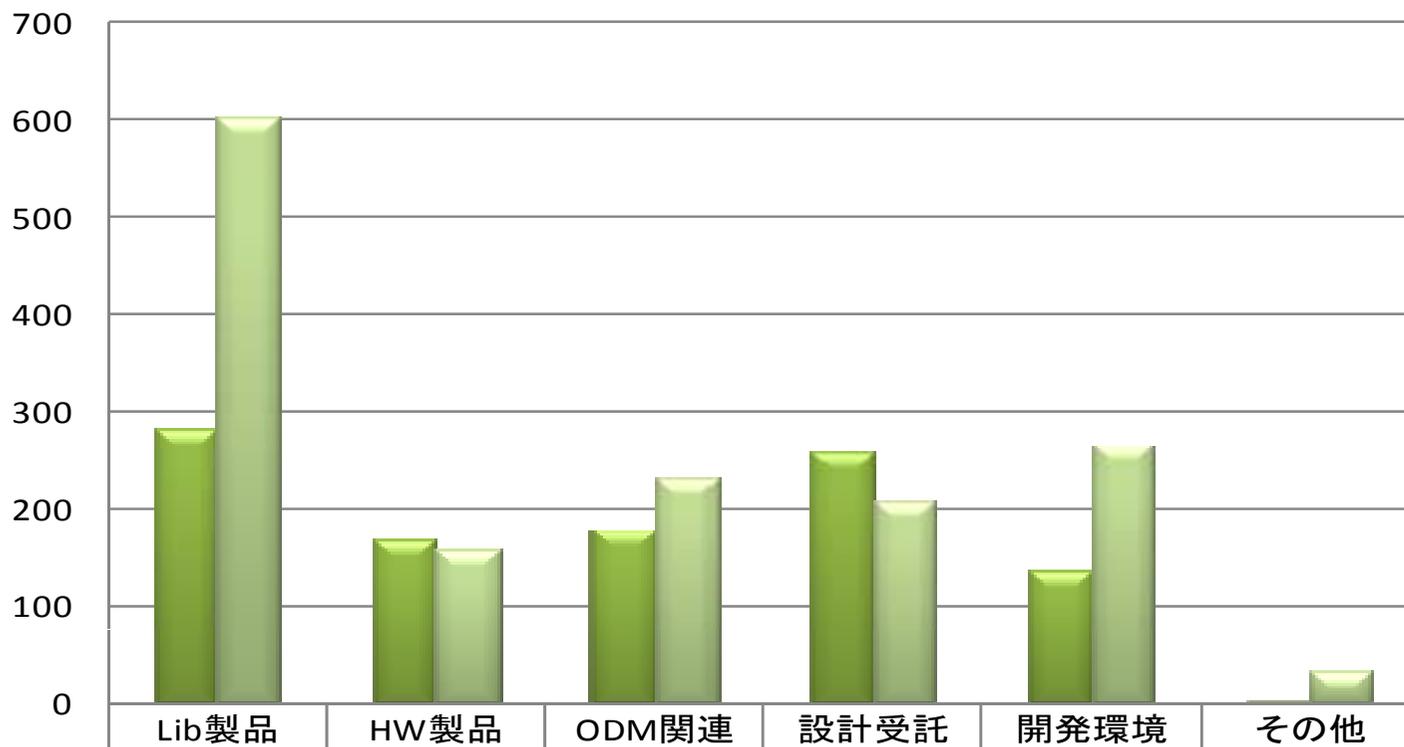


粗利



# 売上高 前年同期比 (製品区分別)

単位：百万円

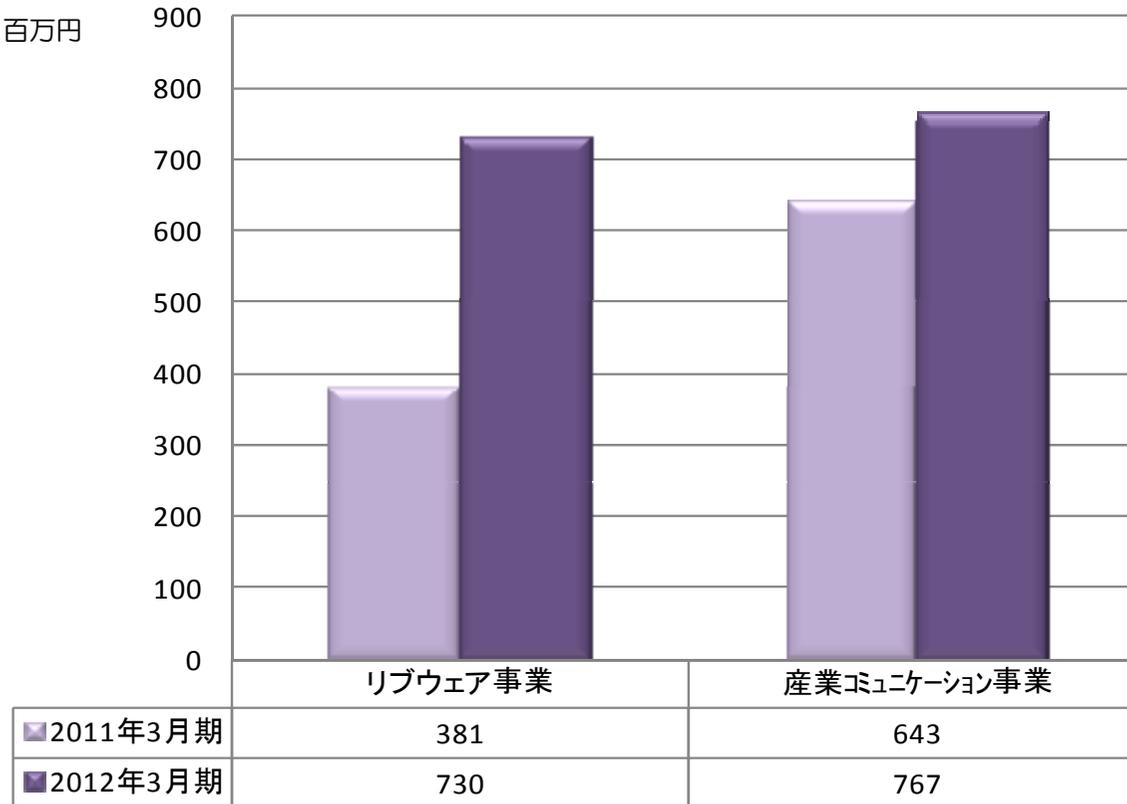


	Lib製品	HW製品	ODM関連	設計受託	開発環境	その他
■ 2011年3月期	283	168	177	258	136	3
■ 2012年3月期	601	158	231	209	265	34

- Lib製品 : IPセキュリティ分野向けライブラリの販売が好調に推移。前年比¥318M増(112%増)
- HW製品 : 暗号モジュール等の大型案件があったものの、今年度は小口取引が中心。新製品拡販が苦戦。前年比¥10M減(6%減)
- ODM関連 : 新規大型案件の売上が大きく貢献し、増加。前年比¥54M増(30%増)
- 受託開発 : 事業方針の転換により特定顧客のみが対象。需要は安定的に確保。
- 開発環境 : 液晶製造関連装置向けに開発環境の大型採用があり、大幅増加。前年比¥129M増(94%増)

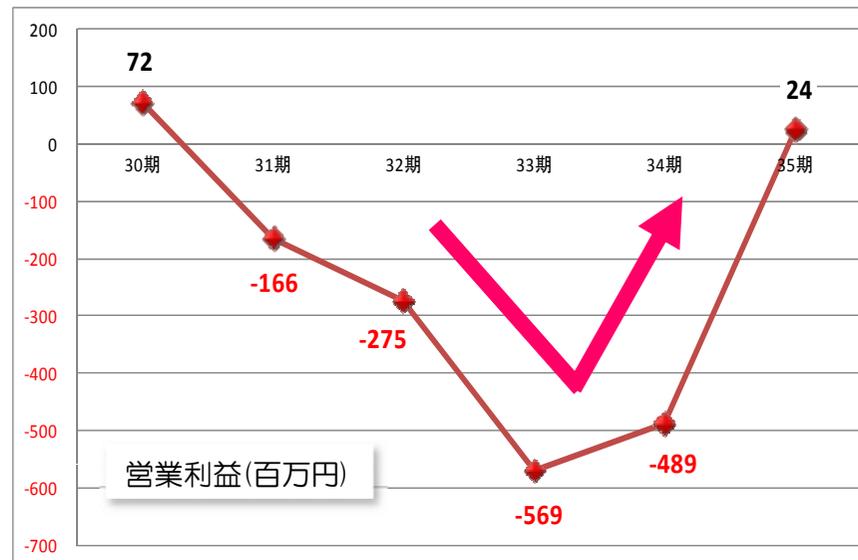
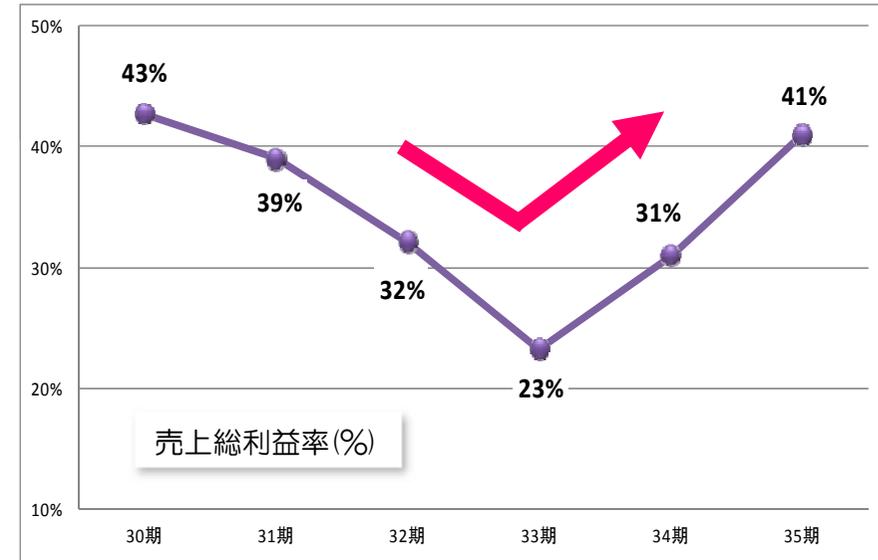
# 売上高 前年同期比 (セグメント別)

単位：百万円



- **ソフトウェア事業**  
IPセキュリティ分野での新製品等の製品販売およびTCP/IP分野でのロイヤルティ収入の増加等により、大幅増加。前年同期比¥349M増(91%増)
- **産業コミュニケーション事業**  
震災の影響等によりHW新製品の販売が伸び悩んだが、ODMビジネスでの大型案件獲得や液晶製造装置向けの開発環境の販売伸長が貢献し、売上高増加。前年同期比¥124M増(19%増)

# 業績推移



# 2013年 3月期 業績見通し

---

**(重点活動方針)**

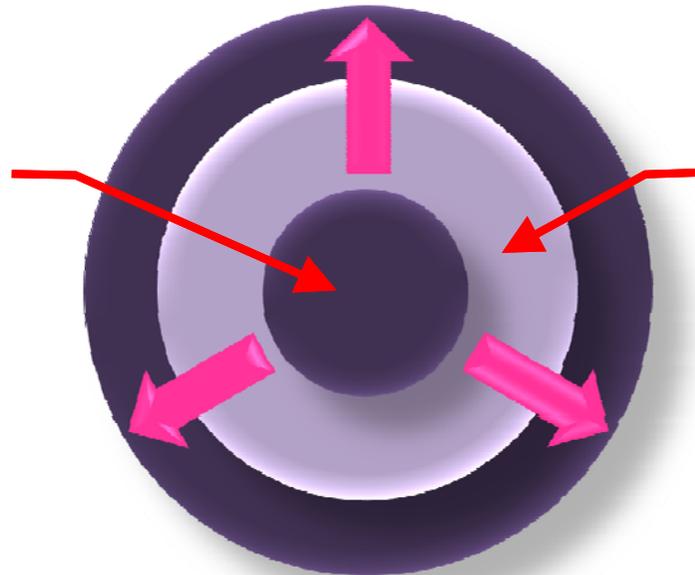
**組込コア技術のリーディング・カンパニー**  
～ Embedded Value-sourcing ～

**付加価値が高く ユニークな  
コア技術を持ち、  
ロイヤルティ/量産供給ビジネスを確立し、  
お客様の事業パートナーとなる。**

# 経営方針

**製品販売を主体とした  
収益力の高いビジネスモデルによる、  
強固な経営基盤の確立**

高付加価値で  
ユニークなコア技術



量産供給やサービスを見据えた応用技術

**コア技術を増強し、技術を連携させ、同心円的にビジネスを拡大。**

# 活動方針

## 1. 継続的な黒字決算

- 3ヶ年計画に基づき、継続的・発展的に業績を拡大させる。

## 2. 高利益なビジネスモデルの確立

- 強固な経営基盤の確立に向け、製品販売を更に拡大する。
- 戦略的な販売パートナーとの良好な関係を構築する。

## 3. 新製品の継続投入により、 ターゲット市場を活性化

- 複数のライブラリ関連の新製品を市場投入する。
- 新たなHW製品シリーズを本格展開する。
- 海外市場において、本格的な販売活動を加速する。

# 中期（3ヶ年）業績計画

単位：百万円、%	2011年度		2012年度		2013年度	
		前年比		前年比		前年比
<b>売上高</b>	1,498	146%	1,570	105%	1,900	121%
<b>営業利益</b>	21	+510	42	+21	230	+188
<b>営業利益率</b>	1.4%		2.6%		12.1%	
<b>製品売上</b>	1,024 (68%)		1,130 (72%)		1,311 (69%)	
<b>ストック売上</b>	435 (29%)		518 (33%)		760 (40%)	

- **売上高 20億円**
- **営業利益率 15%** (売上総利益率50%以上)
- **製品関連の売上比率70%以上**
- **ストック売上比率50%以上** (ロイヤルティ/量産供給などエンジニアリソース非依存の売上)

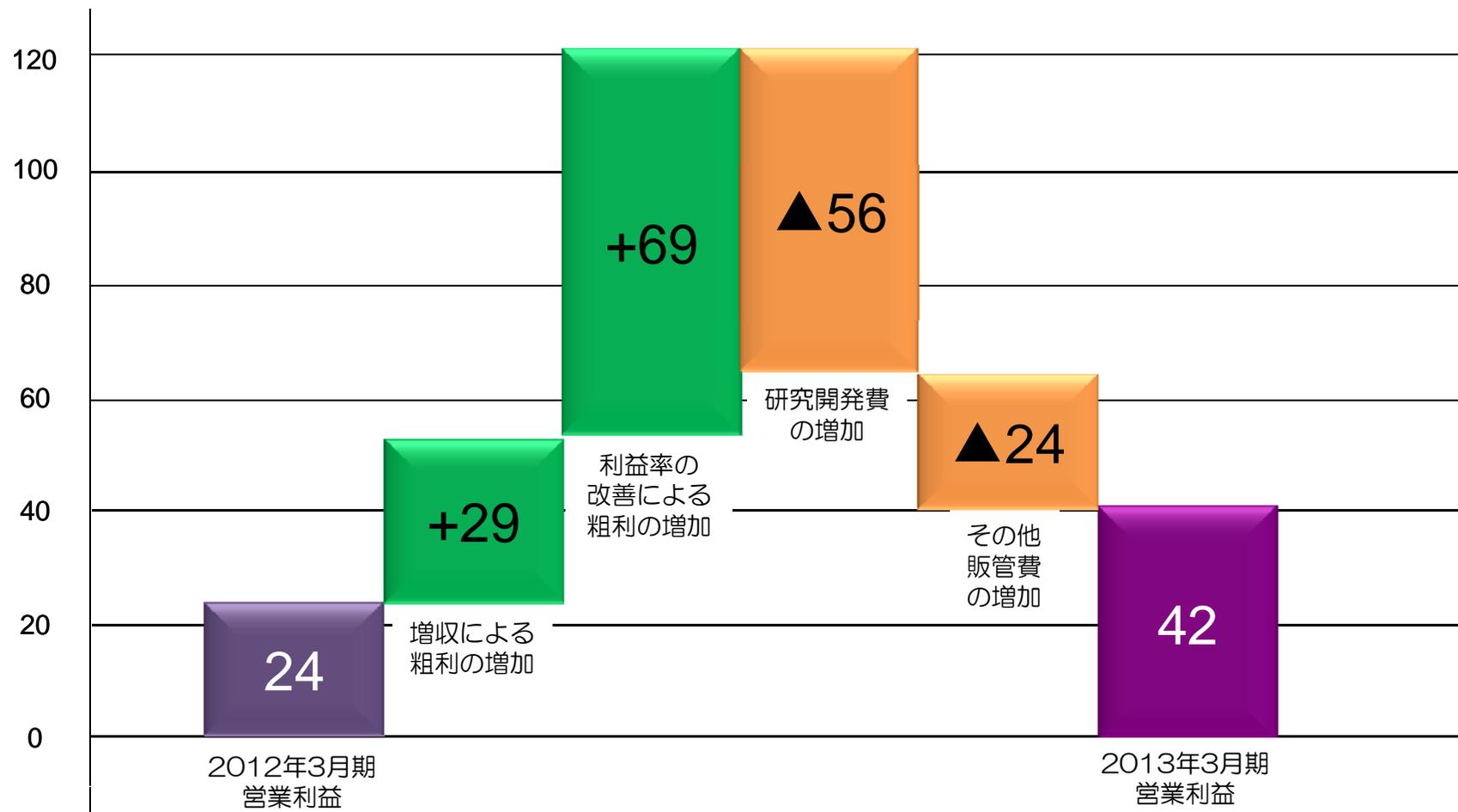
# 2013年 3月期 業績見通し

36期 単位：百万円, %	第2四半期 累計		通期	
	見込	前年 同期比	見込	前年 同期比
売上高	770	115%	1,570	105%
売上原価	447	112%	855	97%
売上総利益	323	120%	715	115%
営業利益	▲20	+3	42	175%
経常利益	▲19	+2	44	129%
当期純利益	▲23	±0	34	+86

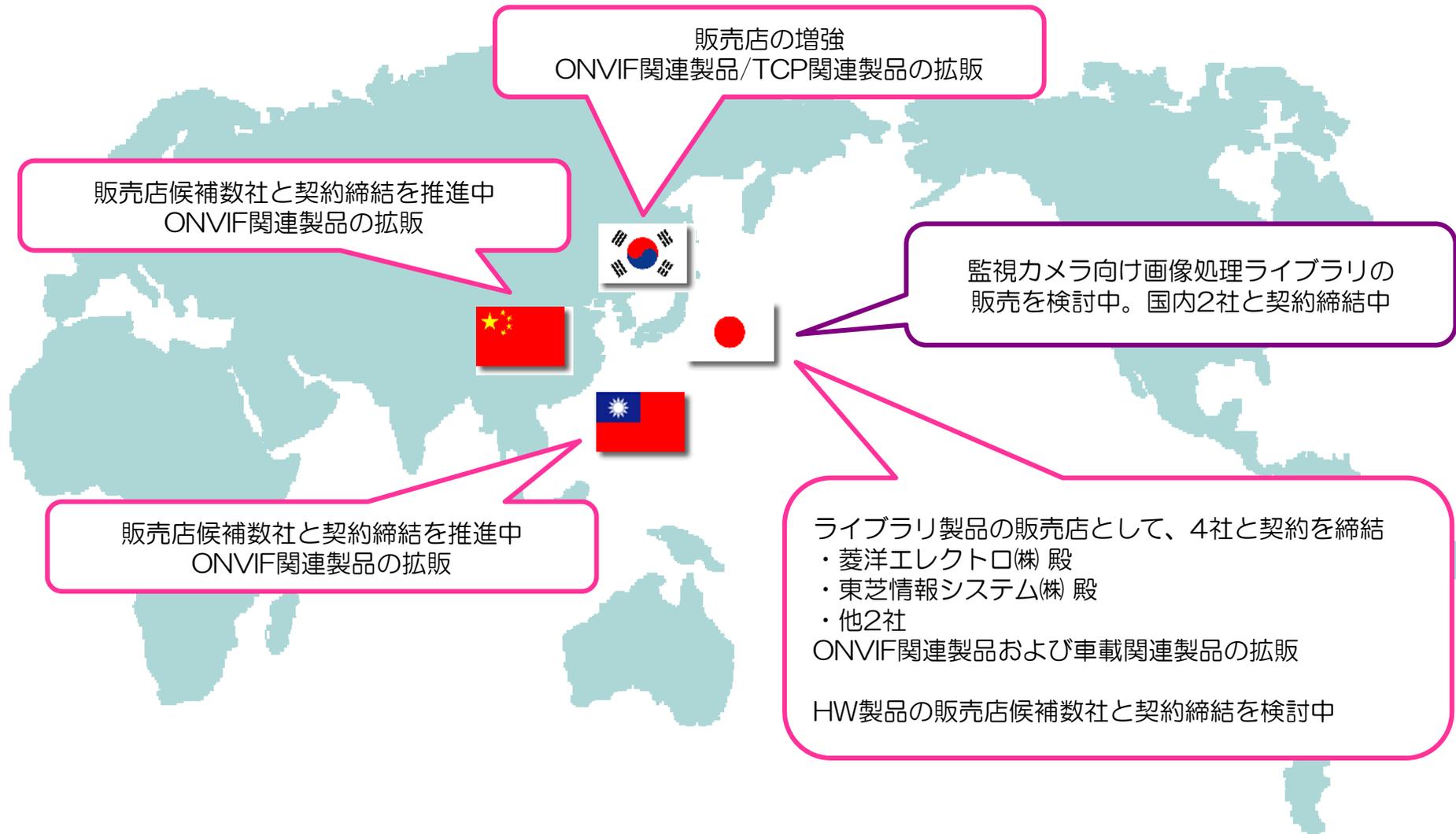
- ライブラリ製品販売, HW製品販売への一層の注力による売上総利益率の向上
- 売上原価の厳格管理による売上原価率の低減
- 新製品リリースによるターゲット市場の活性化と業績拡大
- 海外顧客の獲得による業績拡大

# 営業利益 増加の内訳

単位：百万円

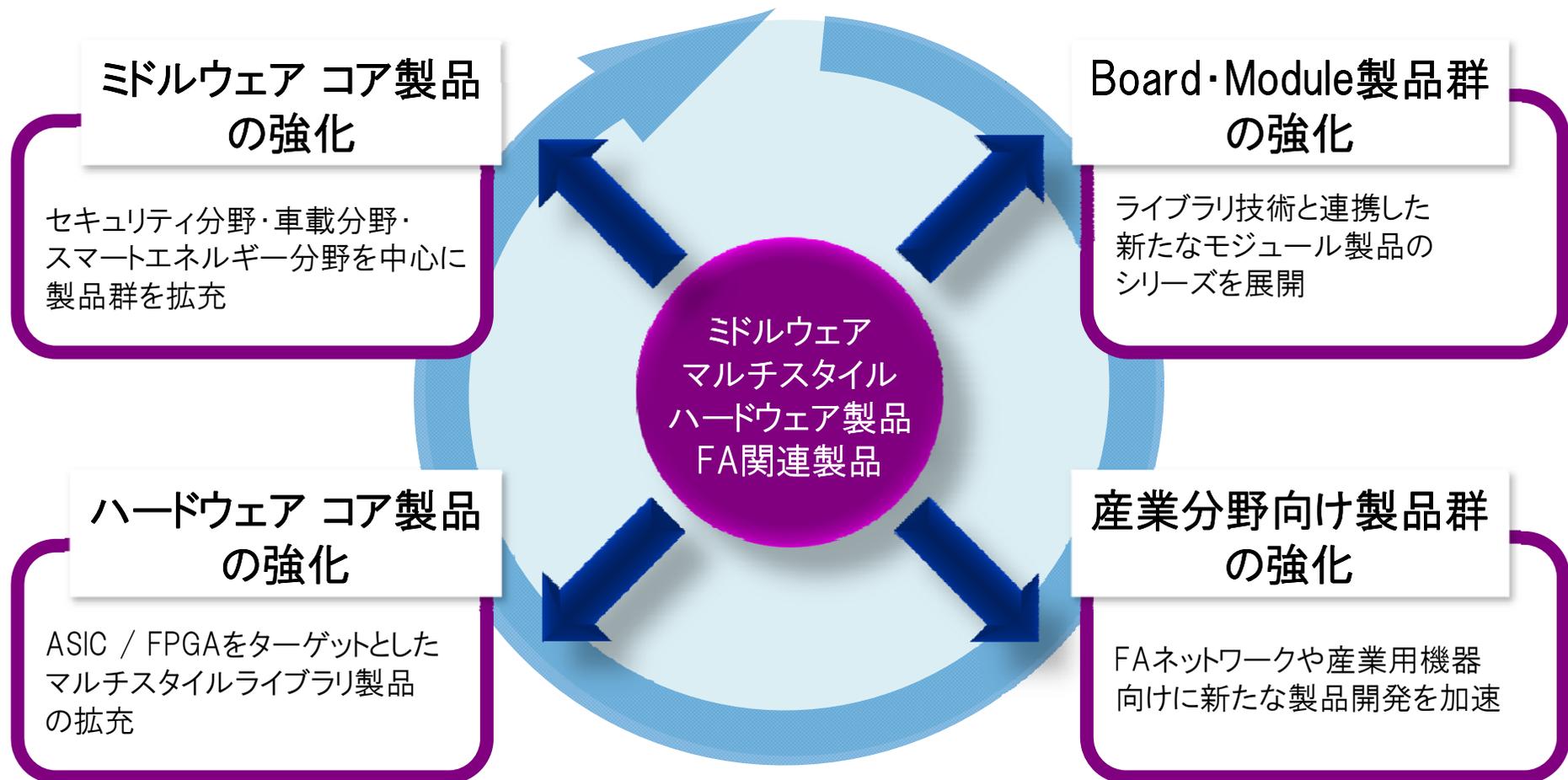


# パートナー戦略の推進



# 開発方針

## ユニークで付加価値のある製品の増強 技術連携した製品の増強

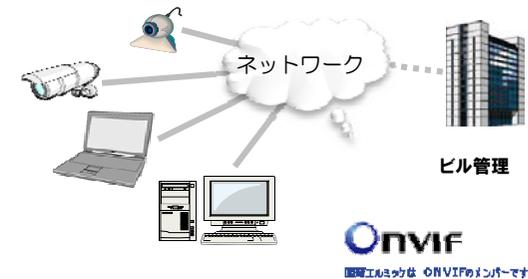


# ミドルウェア コア製品

当社が長年培ってきたIPネットワークに関する技術を更に発展させ、3つのアプリケーション分野の製品群を強化。

## 1. IPセキュリティ分野

- IPセキュリティ機器向け標準IF規格であるONVIF準拠のライブラリ群を拡充
- 暗号技術に関連するライブラリの増強



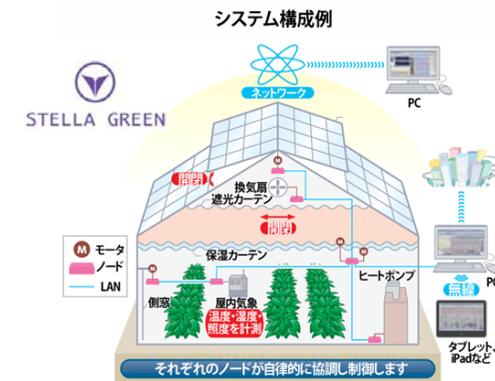
## 2. 車載分野

- TCP/IP技術を発展させ、新たなライブラリパッケージを拡充
- スマートフォン連動や新しい車内ネットワーク向けの製品の増強



## 3. スマートエネルギー分野

- スマートグリッドや電力監視などの分野向けにTCP/IP技術を中心に製品提供を強化
- 無線通信技術やシステム開発技術を持つパートナーと連携して、製品の市場投入を加速

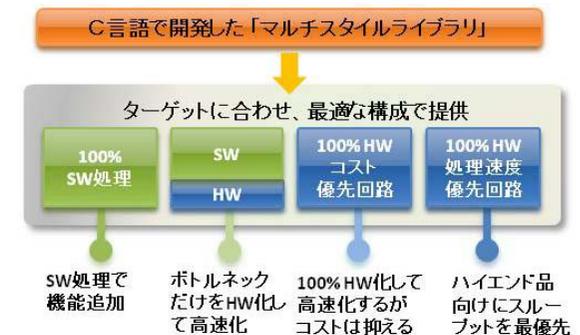


# ハードウェア コア製品 (マルチスタイルライブラリ)

当社が持つC言語によるLSI設計技術を元に、機能実装を柔軟に行えるマルチスタイルライブラリ製品群を拡充させ、ASIC/FPGA向けの新たなライブラリ提供ビジネスを加速

## 1. セキュリティ分野

- 自社ミドルウェアで実現されている暗号機能をASIC/FPGAで使用できるマルチスタイル化し、ターゲット市場をLSI開発者まで拡大

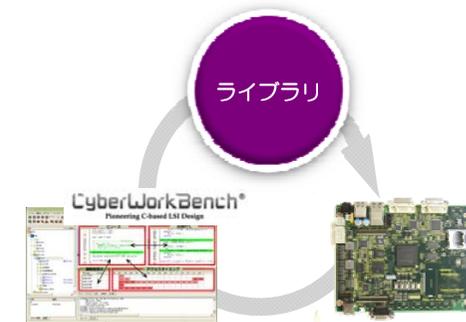


## 2. 画像処理分野

- ミドルウェアライブラリのターゲット市場であるIPセキュリティ分野の顧客向けに、画像処理製品群を拡充
- 画像処理ライブラリを持つパートナー企業と連携強化

## 3. 開発環境ビジネスとの連携

- NEC製 動作合成ツールCyberWorkBench向けライブラリとして提供し、ビジネスを拡大
- 評価ボードを開発・提供し、幅広い顧客層へライブラリをアピール

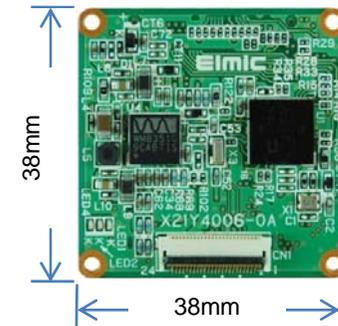


# Board・Module製品

当社が持つミドルウェアライブラリとハードウェア開発技術を連携させ、新たなモジュール製品シリーズを拡充

## 1. 監視カメラ分野

- 自社のONVIF準拠ライブラリ(Ze-PRO IPcam)を実装したハードウェアモジュールを開発。少量生産やネットワーク技術を持たない顧客層へ拡販
- 顧客ニーズに応じ、FullHD対応などのシリーズ製品を企画・開発



ONVIFモジュール(仮称)

既存のカメラモジュールやセンサーモジュールと組合せネットワークカメラ化を実現。

## 2. 無線通信分野

- TCP/IPをはじめとする自社の通信ミドルウェアと連携し、無線通信モジュールを開発
- ハードウェア コア製品と連携し、更に製品群を拡充
- ONVIFモジュールとの組み合わせにより、監視カメラの無線化提案を実施



WLANモジュール(開発中)

# 産業分野向け製品

当社が培ってきた産業分野での経験を元に、FAネットワークや産業機器向けの製品群を拡充

## 1. PC-98互換システム

- 産業機器や工作機械、半導体製造装置などで広く使用されているPC-98における、設備の老朽化・保守部品の入手性悪化・設備入替投資の抑制などの課題に対し、コスト・稼働リスクが最小限の提案を推進
- 設置スペースを考慮した小型版を新規投入



iNHERITOR II

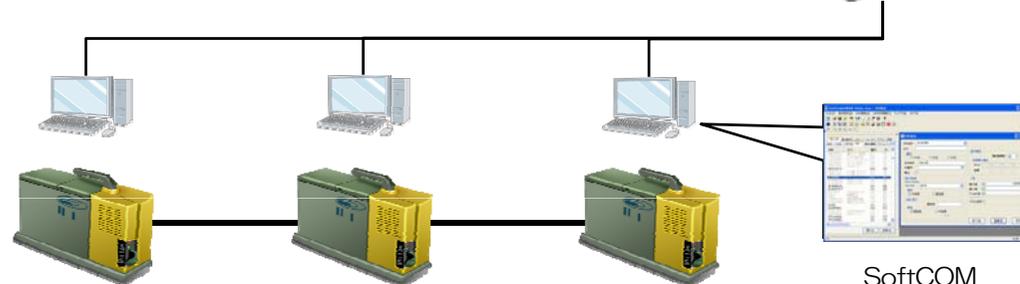
## 2. FAネットワーク分野

- 各種製造ラインの機器とHOST間での通信を可能とするSEMI規格準拠の当社製品SoftCOMの技術を発展させ、FAネットワークにおける新製品の開発を加速

工場HOST  
(生産管理システム)

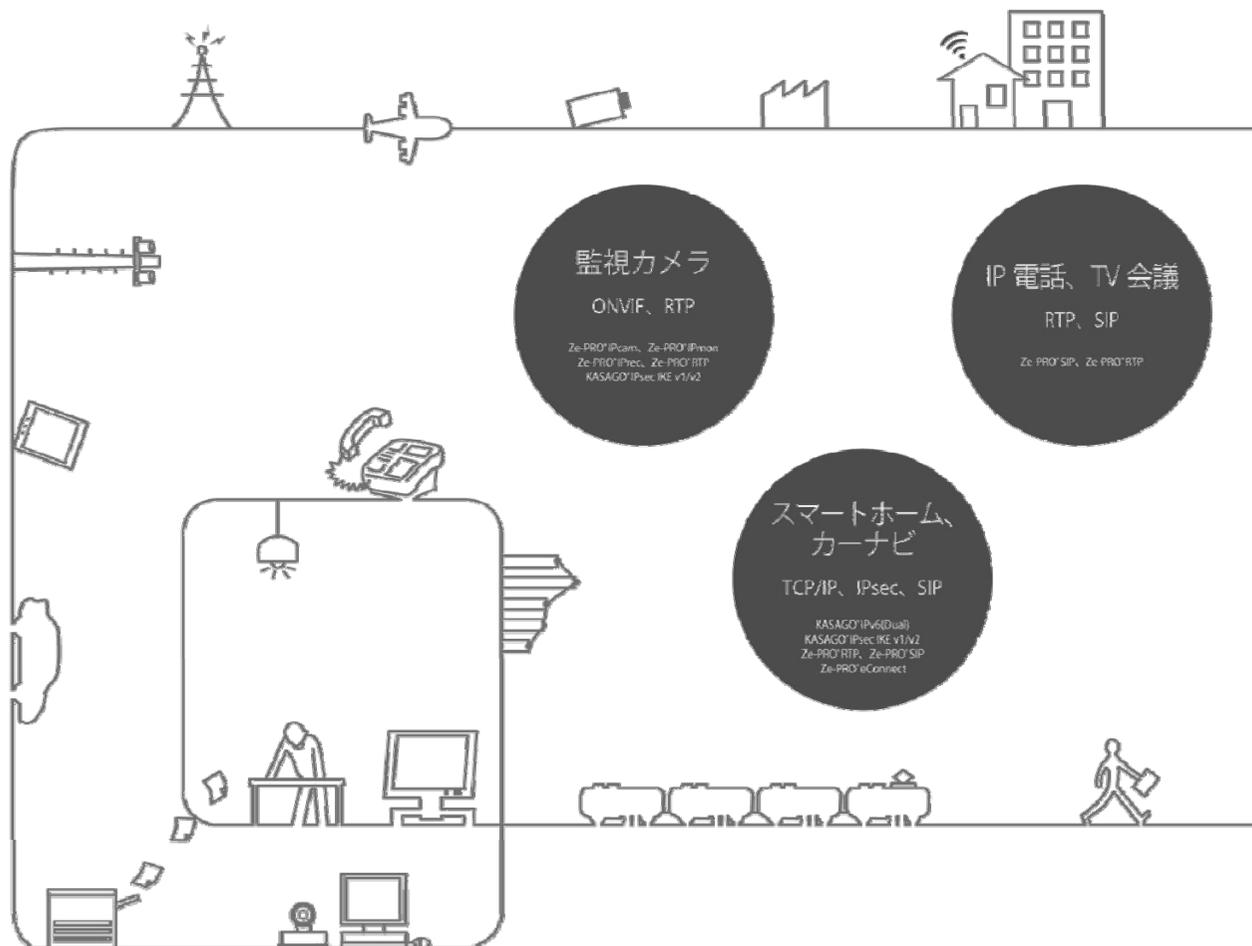


製造装置



SoftCOM

# つなぐ 先端ネットワーク技術を「素材」に変えて提供します。



## 図研エルミック株式会社

Tel : 0120-045-690

URL : <http://www.elwsc.co.jp/>

Email : [info@elwsc.co.jp](mailto:info@elwsc.co.jp)

- ご注意 -

本プレゼンテーション資料および図研エルミック代表者が口頭にて提供する情報には、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているもの又は暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されています。